



## 帶動USB3.0轉換潮 慧榮提供超高效能、具成本優勢USB3.0解決方案

October 9, 2013

【2013/10/9 台北訊】全球NAND Flash控制晶片領導廠商慧榮科技(NasdaqGS: SIMO) 今日宣佈新推出的USB3.0隨身碟控制晶片SM3267已開始送樣，該產品是一款具超高效能及成本優勢的單通道解決方案。SM3267整合了石英振盪器及所有電源IC，能大幅降低客戶產品的系統成本。此外，SM3267讀取速度最高達每秒160MB，寫入最高達每秒60MB，與業界其他單通道解決方案相比，增加了30%~50%的讀取效能。

「我們很高興推出SM3267，這是慧榮第一款無需加掛石英振盪器(Crystal-less)並整合電源IC的USB3.0控制晶片。」慧榮科技總經理苟嘉章表示：「與目前市場上其他USB3.0控制晶片相較，SM3267提供了絕佳的效能及價格競爭優勢，為客戶節省15%~20%的系統成本，在價格敏感度極高的USB控制晶片市場已引發震撼，勢必帶動整體市場從USB2.0規格轉換成最新一代的USB3.0。很高興目前慧榮客戶幾乎都已開始測試SM3267，包括許多一線的OEM客戶，多款採用SM3267的USB3.0隨身碟可望於2013年第四季問市。」



日前全球市場研究機構TrendForce預估2013全年度USB3.0隨身碟約佔整體市場的10%，2014年USB3.0滲透率預計將大幅提升至20%~25%，其中控制晶片商及模組廠能否有效縮小USB2.0及USB3.0產品間的價差，成為帶動USB3.0轉換的重要關鍵。

SM3267所整合的電源IC，包括一顆5伏特轉3.3伏特的低壓差線性穩壓器(LDO)以及一顆5伏特轉1.2伏特的直流電源轉換器(DC-DC)。先進的內嵌電源設計技術，與其他內嵌電源IC的控制晶片相比，能降低25%至30%的隨身碟裝置溫度。

SM3267廣泛支援多數的NAND Flash，包括三星、東芝、新帝、SK海力士、美光和英特爾2y/1x/1y奈米製程的TLC及MLC，以及高速Toggle與ONFI DDR NAND。SM3267已通過USB開發者論壇(USB-IF)相容性測試及微軟Windows 7及Windows 8的硬體認證(WHCK)。採COB(Chip-on-board)及48-PIN QFN綠色封裝，SM3267提供客戶量產所需的Turnkey解決方案，精巧的體積適用於市場上主流的USB2.0隨身碟模組。